



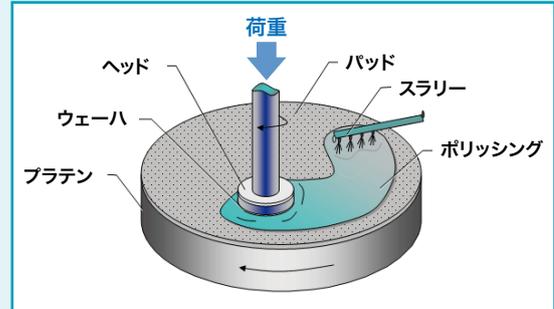
キーワード解説

ミニマルファブ

現在のデバイス製造に必要な大規模工場(メガファブ)に対して、多品種少量生産に特化した超小型製造システムがミニマルファブである。人サイズの同じ外観に標準化された小型製造装置に半導体製造一工程ごとの機能を詰め込み、これらを複数台連結することでデバイスチップを生産する。投資額と電力消費をメガファブの1/1,000にすることを目指している。

CMP

化学機械平坦化(Cheical Mechanical Planarization)もしくは、化学機械研磨(Cheical Mechanical Polishing)の略。研磨液(スラリー)に含まれている砥粒の機械的作用と、薬液の化学的作用の相乗効果により、ウェーハ表面を平坦化する技術。研磨後のウェーハ表面には、砥粒、研磨屑、有機残渣、金属不純物などが残留するため、CMP後は専用の薬液などで適切な洗浄を行う必要がある。



スラリー

CMPに使用される研磨液。SiO₂やCeO₂などの研磨砥粒、pH調整剤、酸化剤、防食剤などを含む。

ガルバニック腐食

異なる金属が溶液中で接触すると局部電池が形成され、電位がより卑な(イオン化傾向が高い)金属で腐食が進行し、もう一方の金属は腐食が抑制される。この異種金属接触腐食をガルバニック腐食と言う。

関東化学のCMP後洗浄液

製品名称	適応プロセス	洗浄対象
CMP-M200シリーズ	W-CMP	パーティクル、有機残渣、金属不純物
CMP-B200シリーズ	Cu-CMP Co-CMP	パーティクル、有機残渣、金属不純物
CMP-B300シリーズ	STI-CMP ILD-CMP	パーティクル、金属不純物

特徴

各種汚染物に対する洗浄性が高い

基板表面の各種材料へのダメージが小さい

希釈して使用が出来るため、プロセスコストの低減が可能

※無断転載および複製を禁じます。



関東化学株式会社

〒103-0022 東京都中央区日本橋室町2丁目2番1号

室町東三井ビルディング

電話(03)6214-1090 FAX(03)3241-1047

HP <http://www.kanto.co.jp/times/>

E-mail : chemiti-info@gms.kanto.co.jp 編集責任者：猪瀬真人

平成 29 年 7 月発行